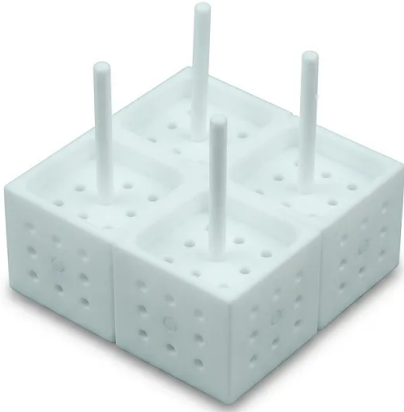


# Benutzerdefinierter Ptfе-Wafer-Reinigungs-Blumenkorb

## Chemikalienbeständiger Fluorpolymer-Träger Für Halbleiterätzung Und Neue Energieverarbeitung

Artikelnummer: PL-CP149



### Einführung

Optimieren Sie Ihre Halbleiter- und New-Energy-Fertigung mit kundenspezifischen PTFE-Wafer-Reinigungs-Blumenkörben. Entwickelt für extreme Chemikalienbeständigkeit während Ätzung und RCA-Reinigung gewährleisten diese hochreinen Fluorpolymer-Träger Prozessintegrität und langfristige Haltbarkeit in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
<b>Halbleiter RCA-Reinigung</b>	Sequenzielle Reinigung von Siliziumwafern mit SC-1- und SC-2-Lösungen zur Entfernung organischer und metallischer Verunreinigungen.	Keine Kontamination und Beständigkeit gegenüber Ammoniak/Peroxid-Gemischen.
<b>Fluorwasserstoffsäure (HF)-Ätzung</b>	Entfernung von natürlichen Oxiden oder kontrollierte Ätzung von Siliziumdioxidschichten auf Waferoberflächen.	Absolute Beständigkeit gegenüber HF, das Glas- oder Quarzalternativen auflösen würde.
<b>Photovoltaik-Texturierung</b>	Nasschemische Ätzung von monokristallinen oder polykristallinen Siliziumwafern zur Erstellung lichtfangender Oberflächen.	Konsistente Schlitzausrichtung gewährleistet gleichmäßige Texturierung über große Chargen.
<b>Piranha-Lösungs-Verarbeitung</b>	Aggressive Entfernung organischer Rückstände und Photolack mit Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid.	Hält extremen exothermen Reaktionen und hochtemperierter Säureeinwirkung stand.
<b>Spülung nach CMP</b>	Kritische Reinigung von Wafern nach chemisch-mechanischem Polieren zur Entfernung von Schleifpasten.	Glatte Oberflächen und hoher Abfluss verhindern erneute Partikelablagerung.
<b>Verbindungshalbleiter-Vorbereitung</b>	Spezialisierte Reinigung von GaAs- oder InP-Wafern für die Herstellung fortschrittlicher elektronischer und optoelektronischer Bauelemente.	Anpassbare Schlitzgeometrie für nicht standardmäßige Waferdicken und -größen.
<b>Beladung von Mikrokanalreaktoren</b>	Positionierung von Substraten in kundenspezifischen Reaktionskammern für kontrollierte chemische Gas- oder Flüssigphasenabscheidung.	Maßgeschneiderte Abmessungen ermöglichen perfekte Passform in kundenspezifischen Laboraufbauten.
<b>Lithografie-Entwicklung</b>	Halten von Substraten während der Entwicklung und Entfernung von Photolackschichten in Mikrofertigungsabläufen.	Lösungsmittelbeständigkeit gewährleistet, dass der Träger während des Prozesses nicht zerfällt oder ausgast.

Parameter	Spezifikationsdetail für PL-CP149
<b>Modellbezeichnung</b>	PL-CP149 Serie
<b>Materialkonstruktion</b>	100% Virgin Hochreines PTFE (Polytetrafluorethylen)
<b>Herstellungsverfahren</b>	Vollständig kundenspezifische CNC-Bearbeitung
<b>Chemische Kompatibilität</b>	Universal (Säuren, Basen, Lösungsmittel, Oxidationsmittel, HF)
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-200°C bis +260°C (-328°F bis +500°F)
<b>Wafer-Kompatibilität</b>	Anpassbar für 2", 3", 4", 6", 8", 12" oder nicht standardmäßige Größen
<b>Schlitzkonfiguration</b>	Vollständig anpassbar (Variabler Abstand, Breite und Tiefe)
<b>Schlitzanzahl</b>	Definiert nach Kundenanforderung (z. B. 10, 25, 50 Kapazität)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Parameter	Spezifikationsdetail für PL-CP149	
Griffdesign	Integriert, abnehmbar oder verlängert (Anpassbare Länge)	
Oberflächenfinish	Glattes, porenarmes bearbeitetes Finish	
Reinheitsstandard	Geeignet für Spurenanalytik und Reinraum der Klasse 10/100	
Ablaufmerkmale	Anpassbare Ablauföffnungen an Boden/Seite	